

IoT社会への進展を支える 半導体産業のコア技術～融合と多様化～

Core technologies of the semiconductor industry supporting the progress in IoT society. -Fusion & Diversification-

2025年3月14日（金） 13:30～17:00

東京理科大学 野田キャンパス & オンライン

社会課題の解決に期待されるIoT（モノのインターネット）では、分散した多種のセンサ情報を収集して流通させることから、多様で高性能なデバイスが必要となる。分野を跨いだ技術の融合による新しい技術の進展にフォーカスし、材料・プロセス・デバイス・回路・システムのレイヤーで半導体産業のコア技術について議論する。

招待講演

鵜野 雄大 日本ガイシ株式会社
常温直接接合を用いた複合ウエハー技術と無線・光通信、
センサーデバイスへの展開



三浦直樹 日本電信電話株式会社
低環境負荷センサデバイス実現に向けた電子回路と電池技術



大橋雄二 東北大学
ランガサイト型単結晶を用いた省電力タイミングデバイス



口地博行 日清紡マイクロデバイス株式会社
AI・IoT応用のためのMEMSマイクロフォンの開発



宮崎史登 株式会社東芝
高精度慣性センサの小型モジュール開発とアプリケーション
への展開



企画 : 集積化MEMS技術研究会(<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>)
世話人 : 島村俊重(NTTイノベーションデバイス)、後藤正英(NHK)、岡本有貴(産総研)
お問合せ : toshishige.shimamura@ntt-devices.com